



nexthardware.com

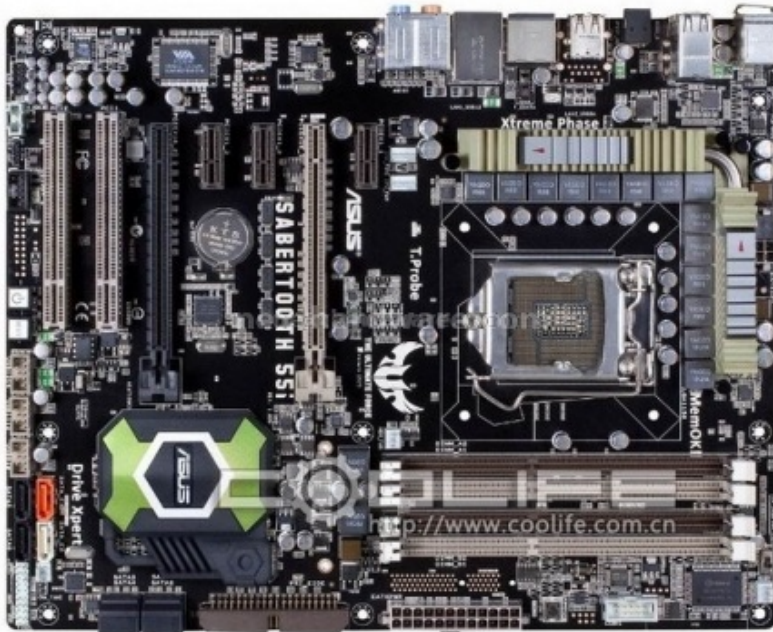
a cura di: Giuseppe Apollo - pippo369 - 21-08-2009 19:58

Asus presenta la mainboard SaberTooth 55i



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/schede-madri/1460/asus-presenta-la-mainboard-sabertooth-55i.htm>)

Asus mostra in anteprima una delle mainboard della nuova serie TUF



Asus sta preparando la nuova serie di schede madri TUF di cui vi mostriamo in anteprima le foto di uno dei modelli.

Simile alla mainboard Marine Cool presentata al CeBIT 2009, la SaberTooth 55i è basata su chipset P55, presenta inoltre un'alimentazione a 12+2 fasi e il nuovo sistema di dissipazione Ceram!X che sfrutta la ceramica per migliorare del 50% la dissipazione del calore rispetto ai dissipatori standard.

Altre caratteristiche sono il doppio slot PCIe x16 con supporto alla tecnologia SLI e CrossFireX, tre slot PCIe x1 e due slot PCI.

The 1st TUF MB: SABERTOOTH 55i

LGA 1156 Socket
 MemOK!
 CoolMem!
 Fan Frame
 CrossFireX & SLI Support
 12+2 Xtreme Phase
 TUF MOSEFETS
 Intel P55 Chipset
 Drive Xpert
 CeraMIX Heat-sink coating Tech.
 T.Probe Micro chip
 All TUF Caps.

ASUS
CONFIDENTIAL

Six Weapons on the SABERTOOTH 55i (1/3)

1. **CeraMIX** Heat-sink Coating Tech.
50% larger area for heat dissipation with the ceramics-coating technology

nexthardware.com
Ultimate Cool for Stability
COOLIFE
http://www.coolife.com.cn

2. **CoolMem!** Fan Frame
Custom fan frame for memory cooling - improves system stability and memory life

The fan is purchased separately.
ASUS
CONFIDENTIAL

CeraMIX Heat-sink Coating Tech. (2/2)

CeraMIX surface has larger area to dissipate heat
COOL!!

With CeraMIX coating, **Heatsink is cooler.**

With CeraMIX (this test)
No CeraMIX (even)

Uneven surface is just like tiny fins extended from heat-sink, effectively conduct heat to the air

http://www.coolife.com.cn

ASUS
CONFIDENTIAL

CeraMIX Heat-sink Coating Tech. (1/2)

Ceramic-coating Heat-sink Module (PCI-E)

Premium Ceramic-coating technology provides **LARGER SURFACE** for heat dissipation

Excellent heat conduction + thermal radiation
→ **Best heat-dissipating** even under poor airflow environment

Ceramic-coating Heat-sink Module (MOSFET)

Micro-porous ceramic + Uneven surface
→ **50% larger surface** to effectively drive heat away from components

Superb heat-resistance + Oxidation-resistance
→ Ultimate **Reliability**

COOLIFE
http://www.coolife.com.cn

ASUS
CONFIDENTIAL

Asus al momento non ha rilasciato molte informazioni sulla disponibilità della nuova serie TUF, riguardo ai prezzi dovrebbero essere inferiori rispetto a quelli della serie ROG.